

为服务器提供可靠、 通过验证的材料

PCBA 材料

主板

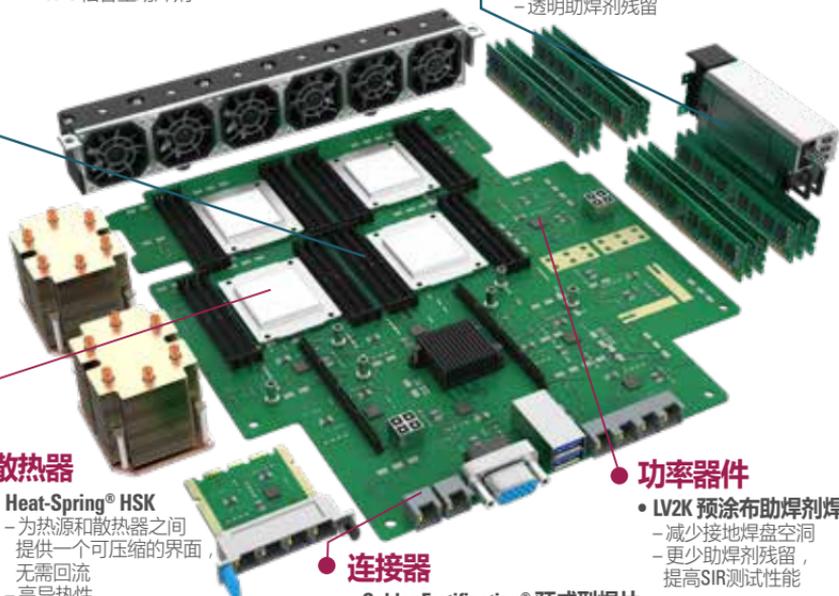
- **Indium10.8HF 焊锡膏**
 - 避免BGA元件翘曲造成的枕头效应缺陷和不润湿开路
 - 在不同的表面处理上均有出色的润湿能力
- **Indium10.2HFA 焊锡膏**
 - 非粘性残留物，具有出色的 ICT 性能
 - 消除枕头效应和不润湿开路缺陷
 - 与底部填充材料超卓越的兼容性
- **Durafuse™ LT 低温合金**
 - 抗跌落特性优于钎基低温合金两个数量级以上
 - 特定条件下，TCT 性能优于SAC305
- **Solder Fortification® 预成型焊片**
 - 精确增加焊锡量，提高机械可靠性
- **波峰焊助焊剂**
 - WF-7745 无VOC 助焊剂
 - WF-9945 松香型助焊剂

内存模块

- **Indium8.9HF 焊锡膏**
 - 有限的助焊剂残留
 - 出色的印刷转移效率
- **Durafuse™ LT 低温合金**
 - 抗跌落特性优于钎基低温合金两个数量级以上
 - 特定条件下，TCT性能优于SAC305
- **Indium5.7LT-1 焊锡膏**
 - 适用于低温合金
 - 透明助焊剂残留

显卡

- **Indium10.8HF 焊锡膏**
 - 避免BGA元件翘曲造成的枕头效应缺陷和不润湿开路
 - 在不同的表面处理上均有出色的润湿能力
- **Indium5.7LT-1 焊锡膏**
 - 适用于低温合金
 - 透明助焊剂残留



散热器

- **Heat-Spring® HSK**
 - 为热源和散热器之间提供一个可压缩的界面，无需回流
 - 高导热性
 - 卓越的热循环性能

连接器

- **Solder Fortification® 预成型焊片**
 - 精确增加焊料量以提高机械可靠性

功率器件

- **LV2K 预涂布助焊剂焊片**
 - 减少接地焊盘空洞
 - 更少助焊剂残留，提高SIR测试性能

工程焊料

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

所有镭泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证
镭泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

©2023 镭泰公司



表格编号: 100099 (SC) R0


INDIUM
CORPORATION®
镭泰公司